

高云的产品变更通知（GPCN）

概述

感谢您使用高云 FPGA 系列器件，此通知的目的是通知受此变更影响的客户注意此次变更，本次变更是为了统一 GW2A-18K 系列 ELQFP 封装产品的晶圆厚度（研磨后），优化产品的生产计划和管理。

描述

型号 GW2A-LV18EQ144 晶圆厚度（研磨后）由 350um 变更为 400um，产品整体尺寸不变。

变更前	1. 型号：GW2A-LV18EQ144 2. 封装形式（尺寸）：ELQFP144L (2020X1.4) 晶圆厚度（研磨后）： <u>350um</u>
变更后	1. 型号：GW2A-LV18EQ144 2. 封装形式（尺寸）：ELQFP144L (2020X1.4) 晶圆厚度（研磨后）： <u>400um</u>

受影响的产品

GW2A-LV18EQ144。

客户影响

此变更未涉及产品外形、尺寸、功能、可靠性、质量及安全的变更，对客户应用无影响。

认证数据

高云已经完成并成功通过了所有必要的认证，可根据要求提供可靠性数据。

关键日期

高云将在 2023 年 12 月 1 日后开始在中市场中供应晶圆厚度（研磨后）为 400um 的产品，晶圆厚度（研磨后）为 350um 的产品库存消耗完成后将不再安排生产与供货。

响应

请客户确认已收到此通知，如对此变更有任何问题或顾虑，请通知我们。如 30 日内没有响应，将默认已接受此变更。

附加文件

无

技术支持与反馈

广东高云半导体科技股份有限公司提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网站：www.gowinsemi.com.cn

邮箱：support@gowinsemi.com

版本信息

日期	版本	说明
2023/09/11	1.0	初始版本。

版权所有©2023 广东高云半导体科技股份有限公司

GOWIN高云、Gowin、GowinSynthesis、云源以及高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标，本手册中提到的其他任何商标，其所有权利属其所有者所有。未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止反言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。